06,13

Реакция диэлектрических параметров пленок (110)SrTiO₃ на формирование в их объеме сегнетоэлектрических доменов

© Ю.А. Бойков, В.А. Данилов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: yu.boikov@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 8 апреля 2019 г. В окончательной редакции 8 апреля 2019 г. Принята к публикации 9 апреля 2019 г.

> Трехслойные гетероструктуры SrRuO₃/SrTiO₃/SrRuO₃ выращены методом лазерного испарения на подложках (110)LaAlO₃. Фотолитография и ионное травление использованы при формировании плоскопараллельных пленочных конденсаторов, в которых слой титаната стронция помещен между двух пленочных электродов из рутената стронция. Получены данные о структуре и ориентации промежуточного слоя SrTiO₃ в выращенных гетероструктурах. Исследовано изменение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь промежуточного слоя SrTiO₃ при варьировании температуры и напряженности внешнего электрического поля.

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери.

DOI: 10.21883/FTT.2019.08.47973.450

1. Введение

При низких температурах (*T* < 77 K) для кристаллов титаната стронция характерны существенная диэлектрическая нелинейность и малая величина диэлектрических потерь $(\tan \delta)$, что обуславливает перспективность их использования в перенастраиваемых элементах СВЧ техники (фазовращатели, линии задержки, и т.д. [1,2]). Для практического применения особый интерес представляют высокосовершенные по структуре пленки SrTiO₃ (STO), интегрированные с проводящими прослойками (электродами) в эпитаксиальных гетероструктурах. Роль электродов в гетероструктурах могут успешно выполнять тонкие слои изоморфных по структуре с STO высоко проводящих оксидов (рутенаты, манганиты [3,4]). В качестве ориентирующих подложек могут быть использованы монокристаллические пластины перовскитоподобных оксидов (алюминат лантана, галлат неодима и т.д.), обладающих низкими значениями тангенса угла диэлектрических потерь при указанных выше температурах и достаточно хорошо согласующиеся с STO по параметрам кристаллических решеток. Подложки (100)LaAlO₃ были успешно использованы при формировании перенастраиваемых СВЧ элементов, включающих эпитаксиальную комбинацию YBa₂Cu₃O_{7-δ}/Ba_{0.05}Sr_{0.95}TiO₃ [5]). От ориентации подложки зависят: а) ориентация слоев в гетероструктуре, б) зарядовое состояние межфазных границ, с) глубина проникновения электрического поля в оксидный электрод, д) интенсивность диффузионного обмена в области межфазных границ, е) уровень механических напряжений в слоях, интегрированных в гетероструктуре. Механические напряжения могут оказывать существенное

влияние на диэлектрические параметры пленок STO, в частности индуцировать появление сегнетоэлектрических доменов в их объеме [2].

2. Эксперимент

Метод лазерного испарения (ComPex 200, KrF, $\lambda = 248 \text{ nm}, \tau = 30 \text{ ns})$ был использован для выращивания на подложках (110)LaAlO₃ трехслойных гетероструктур SRO/STO/SRO. Температура подложки при формировании гетероструктуры равнялась 780°С, давление кислорода (РО2) в ростовой камере поддерживалось на уровне 0.2 mbar. Плотность лазерного излучения на поверхности испаряемых керамических мишеней STO и SRO равнялась 1.7 J/cm². Пленки STO имели толщину $d = 600 \,\mathrm{nm}$, а толщина электродов SRO составляла 200 nm. Данные о структуре промежуточного слоя STO и электродов SRO были получены с использованием рентгеновской дифракции (Philips X'pert MRD, $CuK\alpha_1, \omega/2\theta$ и φ — сканы). Фотолитография и ионное травление (Ar⁺, 600 V) были использованы при формировании верхних электродов ($S = 80 \times 80 \,\mu m^2$) плоскопараллельных, пленочных конденсаторов и "окон" для обеспечения контакта с нижним, общим для всех (9 штук), сформированных на подложке алюмината лантана, пленочных конденсаторов. Емкость (C) и tan δ сформированных конденсаторов измерялись с использованием Agilent *hp* 4263B LCR meter (f = 10-100 kHz) при подаче на электроды напряжения смещения (V_b) и без него. Vb считалось положительным, когда + был подан на верхний электрод. При T = 300 К разброс в величине емкости сформированных на чипе конденсаторов не превышал 15%. Диэлектрическая проницаемость (ε промежуточного слоя STO рассчитывалась с использованием соотношения $\varepsilon = Cd/S\varepsilon_0$, где ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума.

3. Результаты и их обсуждение

Рентгеновский скан, визуализированный для гетероструктуры SRO/STO/SRO, выращенной на подложке (110)LaAlO₃, показан на рис. 1. На дифрактограмме четко разрешаются пики (*nn*0) от подложки и от промежуточного слоя STO. Последние частично перекрывались с относительно слабыми рентгеновскими пиками от нижнего и верхнего электродов SRO. Это стало причиной искажения рентгеновских пиков титаната стронция со стороны малых значений 2θ , см. вставку (*b*) на рис. 1.

Рассогласование в параметрах элементарных ячеек рутената стронция ($a_{\rm SRO} = 3.923$ Å [3]) и титаната стронция ($a_{\rm STO} = 3.905$ Å [6]) индуцировало появление в промежуточном слое STO растягивающих в плоскости подложки, механических напряжений. Частичной релаксации напряжений в слое титаната стронция способствовало появление малоугловых межкристаллитных границ в слоях, интегрированных в гетероструктуре. Кристаллические зерна с эффективным латеральным размером порядка 250 nm четко разрешались на изображении свободной поверхности гетероструктуры, полученном с использованием микроскопа атомных сил, см. вставку (a)



Рис. 1. Рентгеновский скан ($\omega 2\theta$, Cu $K\alpha_1$), визуализированный для гетероструктуры SRO/STO/SRO, выращенной на подложке (110)LAO, приведен на рис. 1. Изображение свободной поверхности сформированной гетероструктуры показано на вставке (*a*). На вставке (*b*) показан рентгеновский пик (110)STO в увеличенном масштабе, стрелкой отмечено его искажение из-за перекрытия с пиками от электродов SRO.



Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (1, 2) и диэлектрических потерь (3, 4) промежуточного слоя STO в емкостной гетероструктуре SRO/STO/STO. *I* и 3 — $V_b = 0$, 2 и 4 — $V_b = 2.5$ V. На вставке показана температурная зависимость $\varepsilon/\varepsilon_0$, визуализированная при $V_b = 0$, пунктиром показана касательная к кривой в интервале температуры 70–200 К.

на рис. 1. Латеральная разориентация кристаллических зерен в слое STO не превышала 0.4 градуса. Эта оценка получена с использованием φ — скана, визуализированного для рефлекса (111)STO от выращенной гетероструктуры SRO/STO/SRO.

Температурные зависимости $\varepsilon/\varepsilon_0$ и tan δ для промежуточного слоя STO в сформированном пленочном конденсаторе, измеренные при напряжении смещения $V_b = +2.5 \,\mathrm{V}$ и без него, приведены на рис. 2. Диэлектрические потери в слое STO уменьшались примерно линейно при понижении температуры в интервале 300 – 90 К, что обусловлено уменьшением проводимости слоя титаната стронция. С понижением частоты измерительного сигнала до 10 kHz потери в указанном интервале температуры увеличивались примерно на 20-25%. При дальнейшем понижении температуры потери в слое титаната стронция резко (в 2-3 раза) возрастали. Максимальные значения $\tan \delta$ для промежуточного слоя STO наблюдались при $T_C \approx 50$ K. Вероятной причиной появления резкого пика на температурной зависимости $\tan \delta \operatorname{vs} T$ является формирование в механически напряженном слое STO сегнетоэлектрических доменов. Вибрация доменных стенок в электрическом поле существенно влияет как на величину измеряемых диэлектрических потерь, так и на величину диэлектрической проницаемости.

Внешнее электрическое поле оказывало существенное влияние на ориентацию и эффективный размер сегнетоэлектрических доменов в промежуточном слое STO. При $T = T_C$ подача напряжения смещения +2.5 V на электроды SRO сопровождалась уменьшением диэлектрических потерь в слое STO примерно в двое.

Диэлектрическая проницаемость промежуточного слоя STO возрастала с понижением температуры в интервале 300-50 К, что обусловлено уменьшением ангармонизма решеточных колебаний и увеличением вклада доменных стенок в $\varepsilon/\varepsilon_0$. При $T \approx 50 \,\mathrm{K}$ и $V_b = 0 \,\mathrm{V}$ на температурной зависимости $\varepsilon/\varepsilon_0$ наблюдался четкий максимум, который становился менее ярко выраженным при подаче на электроды напряжения смещения +2.5 V. Следует отметить, что максимум на зависимости $\varepsilon/\varepsilon_0$ vs T, визуализированной для слоя STO в гетероструктуре SRO/STO/SRO, выращенной на подложке (110)LAO, наблюдался при температуре примерно на 25 К выше, чем максимум на соответствующей зависимости, полученной [7] для слоя титаната стронция, когда подложка (110)LAO была заменена на подложку (100)LSATO, которая обеспечивает низкий уровень механических напряжений в промежуточном слое STO.

В интервале температуры 70–200 К обратная величина диэлектрической проницаемости слоя STO возрастала практически линейно с повышением температуры см. вставку на рис. 2. Касательная к кривой $\varepsilon/\varepsilon_0$ vs *T* показана пунктиром на вставке, данные по ее наклону были использованы для получения оценки постоянной Кюри ($C_0 \approx 0.6 \cdot 10^5$ K) для промежуточного слоя STO в гетероструктуре SRO/STO/SRO. Полученное значение для C_0 хорошо согласуется с соответствующим параметром для объемных кристаллов STO.

При T > 150 К внешнее электрическое поле практически не оказывало влияния на диэлектрическую проницаемость промежуточного слоя STO и на tan δ , см. рис. 2. Это свидетельствует о не значительном влиянии включений сегнетоэлектрической фазы на диэлектрические параметры выращенных слоев STO при указанных выше температурах.

4. Заключение

Метод лазерного испарения использован для формирования на подложках (110)LAO трехслойных эпитаксиальных гетероструктур, в которых слой STO толщиной в 600 nm интегрирован с оксидными электродами. Механические напряжения, индуцированные разницей в параметрах кристаллических решеток титаната и рутената стронция, способствовали появлению при температуре порядка 50К сегнетоэлектрических доменов в промежуточном слое в слое STO.

Финансирование работы

Финансовая поддержка данных исследований была получена из Президиума РАН.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] О.Г. Вендик. ФТТ 51, 1441 (2009).
- [2] Y.L. Li, S. Choudhury, J.H. Haeni, M.D. Biegalski, A. Vasudevarao, A.Y.L. Li, S. Choudhury, J.H. Haeni, M.D. Biegalski, A. Vasudevarao, A. Sharan, H.Z. Ma, J. Levy, Sharan, H.Z. Ma, J. Levy, Venkatraman Gopalan, S. Trolier-McKinstry McKinstry, D.G. Schlom, Q.X. Jia, L.Q. Chen. Phys. Rev. B 73, 184112 (2006).
- [3] P.A. Cox, R.G. Egdell, J.B. Goodenough, A. Hamnett, C.C. Naish. J. Phys. C 16, 6221 (1983).
- [4] G. Jeffrey Snyder, Ron Hiskes, Steve DiCarolis, M.R. Beasle, T.H. Geballe. Phys. Rev. B 53, 14434 (1996).
- [5] R.A. Chakalov, Z.G. Ivanov, Yu.A. Boikov, P. Larsson, E. Carlsson, S. Gevorgian, T. Claeson. Physica C 308, 279 (1988).
- [6] R.W.G. Wyckoff. In: Crystal Structures. 2nd ed. Interscience, N.Y.(1964). V. 2, 394 p.
- [7] Ю.А. Бойков, В.А. Данилов. ФТТ 3, 594 (2019).

Редактор Т.Н. Василевская